

SNx4AHC123A デュアル、再トリガ可能、モノステーブルマルチバイブレータ

1 特長

- 2V~5.5V の V_{CC} で動作
- \bar{A} 、B、および \overline{CLR} 入力のシュミットトリガ回路により、低速の入力遷移レートが可能
- アクティブ High またはアクティブ Low のゲーテッドロジック入力でエッジトリガ可能
- 非常に長い出力パルスに対して再トリガ可能
- クリア信号をオーバーライドすることで、出力パルスが終了
- グリッチが発生しないパワーアップ時の出力リセット
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能

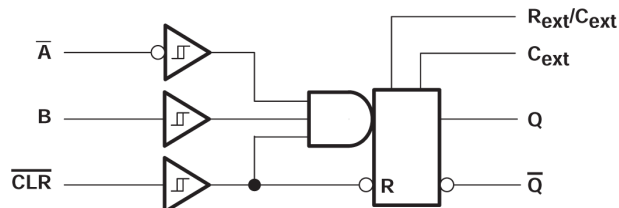
2 概要

'AHC123A デバイスは、2V ~ 5.5V の V_{CC} で動作するように設計された再トリガ可能なデュアルモノステーブルマルチバイブレータです。

製品情報

部品番号	パッケージ ⁽¹⁾	パッケージサイズ ⁽²⁾	本体サイズ (公称) ⁽³⁾
SNx4AHC123A	DB (SSOP, 16)	6.50 mm × 7.8mm	6.50 mm × 5.30mm
	PW (TSSOP, 16)	5.00 mm × 6.4mm	5.00 mm × 4.40mm
	DGV (TVSOP, 16)	3.60 mm × 6.4mm	3.60 mm × 4.40mm
	N (PDIP, 16)	19.3 mm × 9.4mm	19.3 mm × 6.35mm
	D (SOIC, 16)	9.00 mm × 6mm	9.00 mm × 3.90mm

- (1) 詳細については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。
- (2) パッケージサイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
- (3) 本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。



各マルチバイブレータの論理図 (正論理)



目次

1 特長	1	6.1 概要.....	10
2 概要	1	6.2 機能ブロック図	10
3 ピン構成および機能	3	6.3 デバイスの機能モード	10
4 仕様	4	7 アプリケーションと実装	11
4.1 絶対最大定格	4	7.1 アプリケーション情報	11
4.2 ESD 定格	4	7.2 電源に関する推奨事項	14
4.3 推奨動作条件	4	7.3 レイアウト	14
4.4 熱に関する情報	5	8 デバイスおよびドキュメントのサポート	17
4.5 電気的特性	5	8.1 ドキュメントのサポート	17
4.6 タイミング要件、 $V_{CC} = 3.3\text{ V} \pm 0.3\text{ V}$	6	8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法	17
4.7 タイミング要件、 $V_{CC} = 5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$	6	8.3 サポート・リソース	17
4.8 スイッチング特性、 $V_{CC} = 3.3\text{ V} \pm 0.3\text{ V}$	6	8.4 商標	17
4.9 スイッチング特性、 $V_{CC} = 5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$	7	8.5 静電気放電に関する注意事項	17
4.10 動作特性	7	8.6 用語集	17
4.11 入力 / 出力タイミング図	8	9 改訂履歴	17
5 パラメータ測定情報	9	10 メカニカル、パッケージ、および注文情報	18
6 詳細説明	10		

3 ピン構成および機能

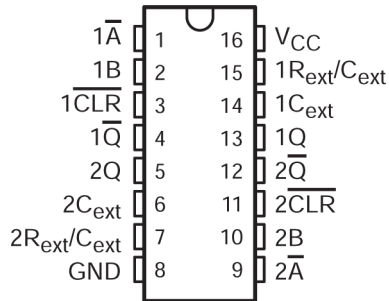
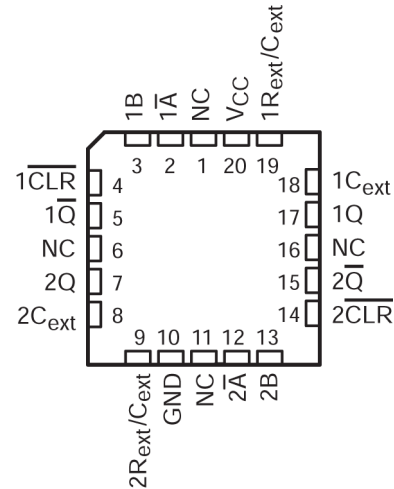


図 3-1. SN54AHC123A J または W パッケージ、SN74AHC123A D、DB、DGV、N、または PW パッケージ、16 ピン CDIP、CFP、SOIC、SSOP、TVSOP、PDIP、または TSSOP (上面図)



NC - No internal connection

図 3-2. SN54AHC123A FK パッケージ、20 ピン LCCC (上面図)

表 3-1. ピンの機能

ピン		I/O1	説明
名称	番号		
1A	1	I	チャンネル 1 立ち下がりエッジトリガ入力 (1B = H の場合)。その他の入力方法では Low に保持します
1B	2	I	チャンネル 1 立ち上がりエッジトリガ入力 ($\overline{1A} = L$ の場合)。その他の入力方法では High に保持します
1 CLR	3	I	チャンネル 1 の立ち上がりエッジトリガ ($\overline{1A} = L$ および 1B = H の場合)。その他の入力方法では High に保持します。出力中に Low を駆動することで、パルス長を短く切ることができます
1 Q	4	O	チャンネル 1 反転出力
2Q	5	O	チャンネル 2 出力
$2C_{ext}$	6	—	チャンネル 2 における外付けコンデンサの負の接続
$2R_{ext}/C_{ext}$	7	—	チャンネル 2 の外付けコンデンサと抵抗接合部接続
GND	8	—	グランド
$2\overline{A}$	9	I	チャンネル 2 立ち下がりエッジトリガ入力 (2B = H の場合)。その他の入力方法では Low に保持します
2B	10	I	チャンネル 2 立ち上がりエッジトリガ入力 ($\overline{2A} = L$ の場合)。その他の入力方法では High に保持します
2 CLR	11	I	チャンネル 2 の立ち上がりエッジトリガ ($\overline{2A} = L$ および 2B = H の場合)。その他の入力方法では High に保持します。出力中に Low を駆動することで、パルス長を短く切ることができます
$2\overline{Q}$	12	O	チャンネル 2 反転出力
1Q	13	O	チャンネル 1 出力
$1C_{ext}$	14	—	チャンネル 1 における外付けコンデンサの負の接続
$1R_{ext}/C_{ext}$	15	—	チャンネル 1 の外付けコンデンサと抵抗接合部接続
V_{CC}	16	—	電源

1. I = 入力、O = 出力、I/O = 入力または出力、G = グランド、P = 電源

4 仕様

4.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)⁽¹⁾

		最小値	最大値	単位
V_{CC} ⁽²⁾	電源電圧範囲	-0.5	7	V
V_I ⁽³⁾	入力電圧範囲	-0.5	7	V
V_O ⁽²⁾	High または Low 状態で印加される出力電圧範囲	-0.5	$V_{CC} + 0.5$	V
V_O ⁽²⁾	電源オフ状態で印加される出力電圧範囲	-0.5	7	V
I_{IK}	入力クランプ電流	$(V_I < 0)$		-20 mA
I_{OK}	出力クランプ電流	$(V_O < 0 \text{ または } V_O > V_{CC})$		±20 mA
I_O	連続出力電流	$(V_O = 0 \sim V_{CC})$		±25 mA
V_{CC} または GND を通過する連続電流				±50 mA
T_{stg}	保管温度範囲	-65	150	°C

- (1) 「絶対最大定格」に示された値を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これらは、ストレス定格のみを示すものであり、これらの条件や「推奨動作条件」に示された値を超える条件で、本製品が機能することを意味するものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。
- (2) すべての電圧値は、回路のグランド端子を基準としたものです。
- (3) 入力と出力の電流定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。

4.2 ESD 定格

		値	単位
$V_{(ESD)}$ 静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠、すべてのピン ⁽¹⁾	±2000	V
	デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JESD22-C101 に準拠、すべてのピン ⁽²⁾	±1000	

- (1) JEDEC ドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。
- (2) JEDEC ドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。

4.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)⁽¹⁾

		SN54AHC123A		SN74AHC123A		単位
		最小値	最大値	最小値	最大値	
V_{CC}	電源電圧	2	5.5	2	5.5	V
V_{IH}	High レベル入力電圧	$V_{CC} = 2 \text{ V}$	1.5	1.5		V
		$V_{CC} = 3 \text{ V}$	2.1	2.1		
		$V_{CC} = 5.5 \text{ V}$	3.85	3.85		
V_{IL}	Low レベル入力電圧	$V_{CC} = 2 \text{ V}$		0.5	0.5	V
		$V_{CC} = 3 \text{ V}$		0.9	0.9	
		$V_{CC} = 5.5 \text{ V}$		1.65	1.65	
V_I	入力電圧	0	5.5	0	5.5	V
V_O	出力電圧	0	V_{CC}	0	V_{CC}	V
I_{OH}	High レベル出力電流	$V_{CC} = 2 \text{ V}$		-50	-50	μA
		$V_{CC} = 3.3 \text{ V} \pm 0.3 \text{ V}$		-4	-4	mA
		$V_{CC} = 5 \text{ V} \pm 0.5 \text{ V}$		-8	-8	
I_{OL}	Low レベル出力電流	$V_{CC} = 2 \text{ V}$		50	50	μA
		$V_{CC} = 3.3 \text{ V} \pm 0.3 \text{ V}$		4	4	mA
		$V_{CC} = 5 \text{ V} \pm 0.5 \text{ V}$		8	8	

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)⁽¹⁾

		SN54AHC123A		SN74AHC123A		単位
		最小値	最大値	最小値	最大値	
R _{ext}	外部タイミング抵抗	V _{CC} = 2 V		5k		Ω
		V _{CC} > 3V		1k		
Δt/ΔV _{CC}	パワーアップ ランプ レート	1		1		ms/V
T _A	自由空気での動作温度	-55	125	-40	85	°C

(1) 未使用の R_{ext}/C_{ext} 端子は未接続のままにします。デバイスが適切に動作するように、デバイスの未使用入力の残りはすべて、V_{CC} または GND に固定する必要があります。テキサス・インスツルメンツのアプリケーションレポート『低速またはフローティング CMOS 入力の影響』(文献番号 SCBA004) を参照してください。

4.4 熱に関する情報

熱評価基準 ⁽¹⁾		SNx4AHC123A					単位
		D (SOIC)	DB (SSOP)	DGV (TVSOP)	N (PDIP)	PW (TSSOP)	
		16 ピン	16 ピン	16 ピン	16 ピン	16 ピン	
R _{θJA}	接合部から周囲への熱抵抗	73	82	120	67	108	°C/W

(1) パッケージの熱インピーダンスは、JESD 51-7 に従って計算しています。

4.5 電気的特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件	V _{CC}	T _A = 25°C			SN54AHC123A		SN74AHC123A		単位
			最小値	標準値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	
V _{OH}	I _{OH} = -50mA	2 V	1.9	2		1.9		1.9	V	
		3 V	2.9	3		2.9		2.9		
		4.5 V	4.4	4.5		4.4		4.4		
V _{OL}	I _{OL} = 50mA	2 V			0.1		0.1	0.1	V	
		3 V			0.1		0.1	0.1		
		4.5 V			0.1		0.1	0.1		
V _{OL}	I _{OL} = 4mA	3 V			0.36		0.5	0.44	V	
		4.5 V			0.36		0.5	0.44		
		4.5 V			0.36		0.5	0.44		
I _I	R _{ext} /C _{ext} ⁽²⁾	V _I = V _{CC} または GND	5.5 V			±0.25		±2.5	±2.5	μA
	A、B、および CLR	V _I = V _{CC} または GND	0V~5.5V			±0.1		±1 ⁽¹⁾	±1	
I _{CC}	静止時	V _I = V _{CC} または GND、I _O = 0	5.5 V			4		40	40	μA
I _{CC}	アクティブ状態 (回路ごと)	V _I = V _{CC} または GND、R _{ext} /C _{ext} = 0.5V _{CC}	3 V		160	250		280	280	μA
			4.5 V		280	500		650	650	
			5.5 V		360	750		975	975	
C _i		V _I = V _{CC} または GND	5 V		1.9	10			10	pF

(1) MIL-PRF-38535 に準拠した製品では、このパラメータについては、V_{CC} = 0V で出荷時のテストは行っていません。

(2) このテストは、端子が OFF 状態のときに実行します。

4.6 タイミング要件、 $V_{CC} = 3.3 V \pm 0.3 V$

自由気流での推奨動作温度範囲内、 $V_{CC} = 3.3V \pm 0.3V$ (特に記述のない限り) (負荷回路および電圧波形を参照)

			テスト条件	$T_A = 25^\circ\text{C}$			SN54AHC123A		SN74AHC123A		単位
				最小値	標準値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	
t_w	パルス幅	CLR		5			5		5	ns	
		\bar{A} または B トリガ		5			5		5		
t_{rr}	パルス再トリガ時間		$R_{ext} = 1k\Omega, C_{ext} = 100pF$	(1)	76		(1)		(1)	ns	
			$R_{ext} = 1k\Omega, C_{ext} = 0.01\mu F$	(1)	1.8		(1)		(1)	μs	

(1) 「アプリケーション情報」セクションでデータの再トリガを参照してください。

4.7 タイミング要件、 $V_{CC} = 5 V \pm 0.5 V$

自由気流での推奨動作温度範囲内、 $V_{CC} = 5V \pm 0.5V$ (特に記述のない限り) (負荷回路および電圧波形を参照)

			テスト条件	$T_A = 25^\circ\text{C}$			SN54AHC123A		SN74AHC123A		単位
				最小値	標準値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	
t_w	パルス幅	CLR		5			5		5	ns	
		\bar{A} または B トリガ		5			5		5		
t_{rr}	パルス再トリガ時間		$R_{ext} = 1k\Omega, C_{ext} = 100pF$	(1)	59		(1)		(1)	ns	
			$R_{ext} = 1k\Omega, C_{ext} = 0.01\mu F$	(1)	1.5		(1)		(1)	μs	

(1) 「アプリケーション情報」セクションでデータの再トリガを参照してください。

4.8 スイッチング特性、 $V_{CC} = 3.3 V \pm 0.3 V$

自由気流での推奨動作温度範囲内、 $V_{CC} = 3.3V \pm 0.3V$ (特に記述のない限り) (負荷回路および電圧波形を参照)

パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	テスト条件	$T_A = 25^\circ\text{C}$			SN54AHC123A		SN74AHC123A		単位
				最小値	標準値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	
t_{PLH}	\bar{A} または B	Q または \bar{Q}	$C_L = 15pF$	9.5 ⁽¹⁾		20.6 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾	24 ⁽¹⁾	1	24	ns
t_{PHL}				10.2 ⁽¹⁾		20.6 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾	24 ⁽¹⁾	1	24	
t_{PLH}	CLR	Q または \bar{Q}	$C_L = 15pF$	7.5 ⁽¹⁾		15.8 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾	18.5 ⁽¹⁾	1	18.5	ns
t_{PHL}				9.3 ⁽¹⁾		15.8 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾	18.5 ⁽¹⁾	1	18.5	
t_{PLH}	$\overline{\text{CLR}}$ トリガ	Q または \bar{Q}	$C_L = 15pF$	10 ⁽¹⁾		22.4 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾	26 ⁽¹⁾	1	26	ns
t_{PHL}				10.6 ⁽¹⁾		22.4 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾	26 ⁽¹⁾	1	26	
t_{PLH}	\bar{A} または B	Q または \bar{Q}	$C_L = 50pF$	10.5		24.1	1	27.5	1	27.5	ns
t_{PHL}				11.8		24.1	1	27.5	1	27.5	
t_{PLH}	CLR	Q または \bar{Q}	$C_L = 50pF$	8.9		19.3	1	22	1	22	ns
t_{PHL}				10.5		19.3	1	22	1	22	
t_{PLH}	$\overline{\text{CLR}}$ トリガ	Q または \bar{Q}	$C_L = 50pF$	11		25.9	1	29.5	1	29.5	ns
t_{PHL}				12.3		25.9	1	29.5	1	29.5	
t_w ⁽²⁾		Q または \bar{Q}	$C_L = 50pF, C_{ext} = 28pF, R_{ext} = 2k\Omega$	182		240		300		300	ns
			$C_L = 50pF, C_{ext} = 0.01\mu F, R_{ext} = 10k\Omega$	90	100	110	90	110	90	110	μs
			$C_L = 50pF, C_{ext} = 0.1\mu F, R_{ext} = 10k\Omega$	0.9	1	1.1	0.9	1.1	0.9	1.1	ms
Δt_w ⁽³⁾				±1						%	

(1) MIL-PRF-38535 に準拠した製品では、このパラメータについては、出荷時のテストは行っていません。

- (2) t_w = パルス持続時間 (Q および \bar{Q} 出力における)
 (3) Δt_w = 同じパッケージの回路間での出力パルス持続時間の変動 (Q と \bar{Q})

4.9 スイッチング特性、 $V_{CC} = 5V \pm 0.5V$

自由気流での推奨動作温度範囲内、 $V_{CC} = 5V \pm 0.5V$ (特に記述のない限り) (負荷回路および電圧波形を参照)

パラメータ	開始 (NPUT)	終点 (出力)	テスト条件	$T_A = 25^\circ\text{C}$			SN54AHC123A		SN74AHC123A		単位
				最小値	標準値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	
t_{PLH}	\bar{A} または B	Q または \bar{Q}	$C_L = 15\text{pF}$	6.5 ⁽¹⁾	12 ⁽¹⁾		1 ⁽¹⁾	14 ⁽¹⁾	1	14	ns
t_{PHL}				7.1 ⁽¹⁾	12 ⁽¹⁾		1 ⁽¹⁾	14 ⁽¹⁾	1	14	
t_{PLH}	CLR	Q または \bar{Q}	$C_L = 15\text{pF}$	5.3 ⁽¹⁾	9.4 ⁽¹⁾		1 ⁽¹⁾	11 ⁽¹⁾	1	11	ns
t_{PHL}				6.5 ⁽¹⁾	9.4 ⁽¹⁾		1 ⁽¹⁾	11 ⁽¹⁾	1	11	
t_{PLH}	$\overline{\text{CLR}}$ トリガ	Q または \bar{Q}	$C_L = 15\text{pF}$	6.9 ⁽¹⁾	12.9 ⁽¹⁾		1 ⁽¹⁾	15 ⁽¹⁾	1	15	ns
t_{PHL}				7.4 ⁽¹⁾	12.9 ⁽¹⁾		1 ⁽¹⁾	15 ⁽¹⁾	1	15	
t_{PLH}	\bar{A} または B	Q または \bar{Q}	$C_L = 50\text{pF}$	7.3	14		1	16	1	16	ns
t_{PHL}				8.3	14		1	16	1	16	
t_{PLH}	CLR	Q または \bar{Q}	$C_L = 50\text{pF}$	6.3	11.4		1	13	1	13	ns
t_{PHL}				7.4	11.4		1	13	1	13	
t_{PLH}	$\overline{\text{CLR}}$ トリガ	Q または \bar{Q}	$C_L = 50\text{pF}$	7.6	14.9		1	17	1	17	ns
t_{PHL}				8.7	14.9		1	17	1	17	
t_w ⁽²⁾		Q または \bar{Q}	$C_L = 50\text{pF}, C_{\text{ext}} = 28\text{pF}, R_{\text{ext}} = 2\text{k}\Omega$	167	200			240		240	ns
			$C_L = 50\text{pF}, C_{\text{ext}} = 0.01\mu\text{F}, R_{\text{ext}} = 10\text{k}\Omega$	90	100	110	90	110	90	110	μs
			$C_L = 50\text{pF}, C_{\text{ext}} = 0.1\mu\text{F}, R_{\text{ext}} = 10\text{k}\Omega$	0.9	1	1.1	0.9	1.1	0.9	1.1	ms
Δt_w ⁽³⁾				± 1						%	

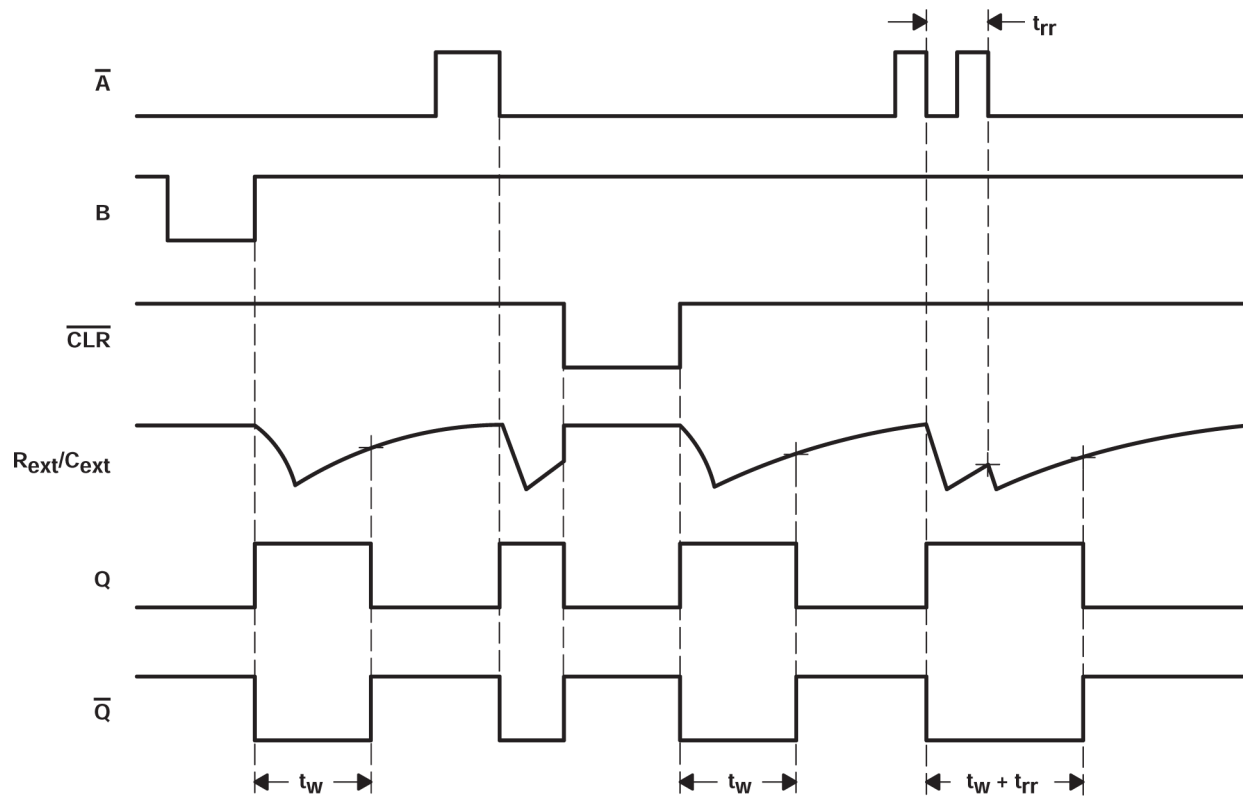
- (1) MIL-PRF-38535 に準拠した製品では、このパラメータについては、出荷時のテストは行っていません。
 (2) t_w = パルス持続時間 (Q および \bar{Q} 出力における)
 (3) Δt_w = 同じパッケージの回路間での出力パルス持続時間の変動 (Q と \bar{Q})

4.10 動作特性

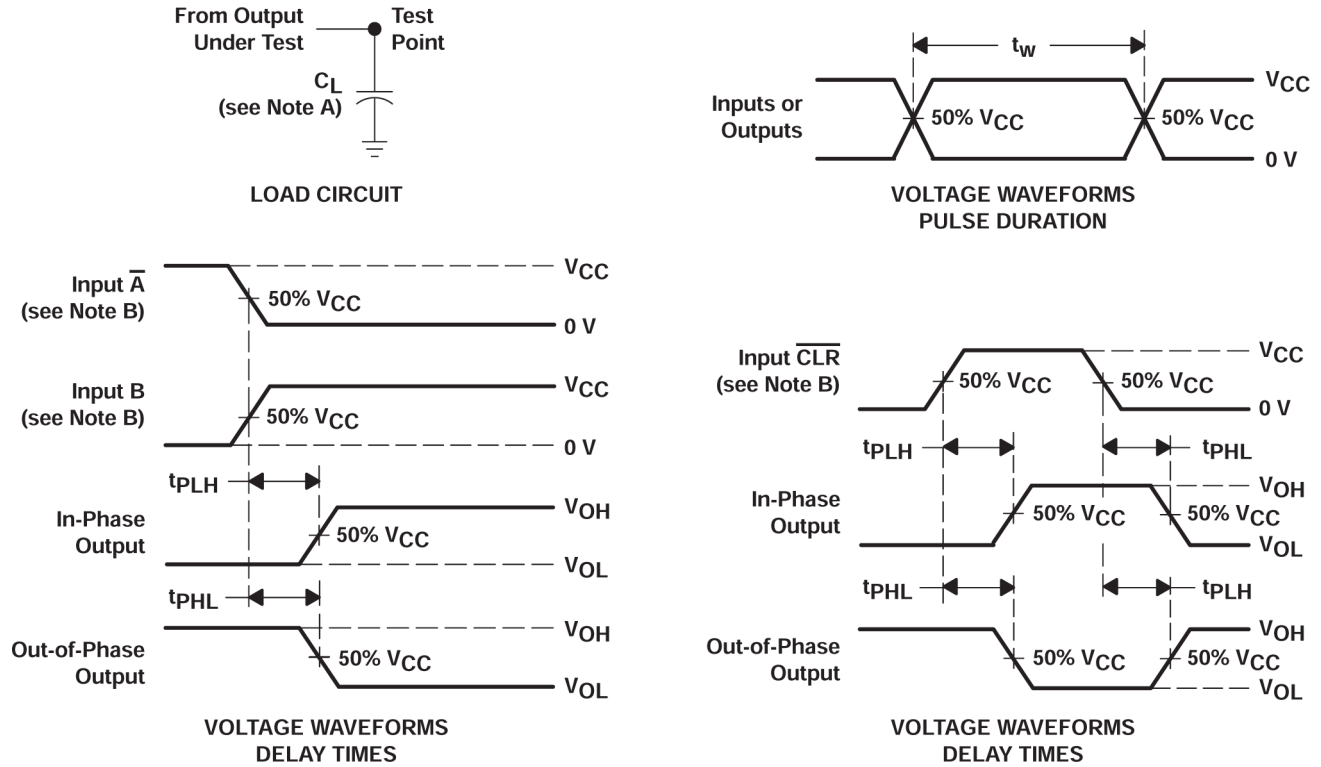
$V_{CC} = 5V, T_A = 25^\circ\text{C}$

パラメータ	テスト条件	標準値	単位
C_{pd}	電力散逸容量	29	pF

4.11 入力 / 出力タイミング図



5 パラメータ測定情報



- A. C_L にはプローブと治具の容量が含まれます。
- B. すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。 $Z_O = 50\Omega$, $t_r + 3ns$, $t_f + 3ns$ 。
- C. 出力は一度に1つずつ測定され、測定するたびに入力が1回遷移します。

図 5-1. 負荷回路および電圧波形

6 詳細説明

6.1 概要

これらのエッジトリガ マルチバイブレータは、出力パルスの持続時間を制御するために、3つの手法を採用しています。1番目の方法では、 \bar{A} 入力が Low のときに、B 入力が High に遷移します。2番目の方法では、B 入力が High のときに、 \bar{A} 入力が Low に遷移します。3番目の方法では、 \bar{A} 入力が Low、B 入力が High のときに、クリア (CLR) 入力が High に遷移します。

出力パルス幅は、外付けの抵抗と容量の値を選択することで設定されます。外付けタイミング コンデンサは C_{ext} と R_{ext}/C_{ext} (正極側) の間に接続する必要があります。外付け抵抗は R_{ext}/C_{ext} と V_{CC} の間に接続する必要があります。パルス持続時間を可変させるには、 R_{ext}/C_{ext} と V_{CC} との間に外付けの可変抵抗を接続します。CLR を Low にすることで、出力パルスの持続時間を低減することもできます。

パルスのトリガは特定の電圧レベルで発生し、入力パルスの遷移時間とは直接関係しません。 \bar{A} 、B、および \overline{CLR} 入力は、入力の遷移速度が遅くても出力にジッタを発生させずにパルス生成するのに十分なヒステリシスを持ったシュミットトリガを備えています。

一度トリガされると、ゲート付きの Low レベル アクティブ (\bar{A}) または High レベル アクティブ (B) 入力を再トリガすることで、基本パルスの持続時間を延長することができます。 \overline{CLR} を Low にすることで、パルスの持続時間を低減することができます。 \overline{CLR} 入力を使用することで、 \bar{A} または B 入力をオーバーライドできます。入力 / 出力のタイミング図は、入力の再トリガと早期クリアによるパルス制御を示しています。

デバイス間での出力パルス持続時間のばらつきは、一般に、特定の外部タイミング コンポーネントについて $\pm 0.5\%$ 未満です。'AHC123A のこの分布の例を図 7-9 に示します。電源電圧および温度に対する出力パルス持続時間の変動を図 7-5 に示します。

電源オン時、Q 出力は Low 状態、Q 出力は High 状態になります。出力は、リセット パルスを印加せずに、グリッチ フリーです。

マルチバイブレータの詳細については、アプリケーション レポート『SN74AHC123A および SN74AHCT123A を使用した設計』(文献番号 SCLA014) を参照してください。

6.2 機能ブロック図

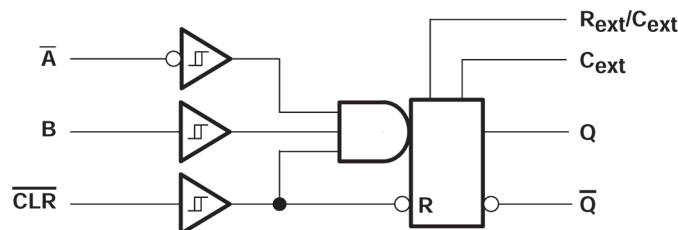


図 6-1. 各マルチバイブレータの論理図 (正論理)

6.3 デバイスの機能モード

表 6-1. 機能表 (各マルチバイブレータ)

入力			出力	
CLR	A	B	Q	\bar{Q}
L	X	X	L	H
X	H	X	L ⁽¹⁾	H ⁽¹⁾
X	X	L	L ⁽¹⁾	H ⁽¹⁾
H	L	↑	⌋	⌋
H	↓	H	⌋	⌋

表 6-1. 機能表 (各マルチバイブレータ) (続き)

入力			出力	
CLR	A	B	Q	Q
↑	L	H	⌋	⌋

- (1) これらの出力は、 \bar{A} 入力と B 入力で指示された定常状態が、その状態がセットアップされる前に開始されたすべてのパルスが完了するくらい十分長い間セットアップされていたという仮定に基づいています。

7 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

7.1 アプリケーション情報

これらの条件や「推奨動作条件」に示された値を超える条件で、本デバイスが動作することを意味するものではありません。

7.1.1 使用上の注意

ノイズによる誤動作を防止するため、 V_{CC} と GND との間に高周波コンデンサを接続し、外付け部品と C_{ext} および R_{ext}/C_{ext} 端子との間の配線をできる限り短くします。

7.1.2 出力パルス持続時間

出力パルス持続時間 t_w は、主に外部静電容量 (C_T) とタイミング抵抗 (R_T) の値によって決定されます。タイミングコンポーネントは、図 7-1 に示すように接続されています。

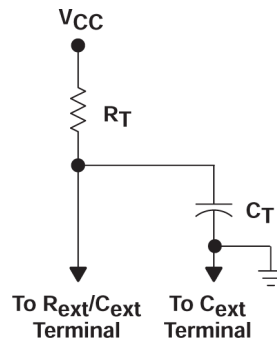


図 7-1. タイミング コンポーネント接続

パルス持続時間は次の式で与えられます。

$$t_w + K \times R_T \times C_T \quad (1)$$

C_T が 1000pF 以上の場合は、 $K = 1.0$ または

C_T が 1000pF 未満の場合は、 K を図 7-6 から求めることができます

ここで

t_w = パルス持続時間 (ns)

R_T = 外部タイミング抵抗 (k Ω)

C_T = 外部静電容量 (pF)

K = 乗数

図 5-1 と図 7-2 を使用して、パルス持続時間、外部抵抗、外部静電容量の値を決定できます。

7.1.3 パワーダウンに関する検討事項

C_{ext} の値が大きい場合、コンデンサ内に蓄積されたエネルギーが原因で、'AHC123A デバイスのパワーダウン時に問題が発生する可能性があります。このデバイスを含むシステムがパワーダウン状態の場合、コンデンサはピン 2 またはピン 14 の保護ダイオードを経由して V_{CC} から放電できます。入力保護ダイオードを流れる電流は 30mA に制限する必要があります。したがって、 V_{CC} 電源のターンオフ時間は $t = V_{CC} \times C_{ext} / 30mA$ よりも高速ではないようにする必要があります。たとえば、 $V_{CC} = 5V$ 、 $C_{ext} = 15pF$ の場合、 V_{CC} 電源は $t = (5V) \times (15pF) / 30mA = 2.5ns$ 以下ではオフにする必要があります。通常、電源装置は高度にフィルタリングされており、このレートで放電できないため、これは問題ではありません。 V_{CC} がさらに急激にゼロに低下すると、'AHC123A デバイスが損傷を受ける可能性があります。この可能性を回避するために、外付けのクランプダイオードを使用します。

7.1.4 データの再トリガ

最小入力再トリガ時間 (t_{MIR}) は、初期信号から入力を再トリガするまでに必要な最小時間です。 t_{MIR} 後、デバイスは出力を再トリガします。実験的には、出力パルスを再トリガするために、2 つの隣接する入力信号が t_{MIR} 離れている必要があることも示します。ここで、 $t_{MIR} = 0.30 \times t_w$ です。再トリガパルス持続時間は、図 7-2 に示すように計算されます。

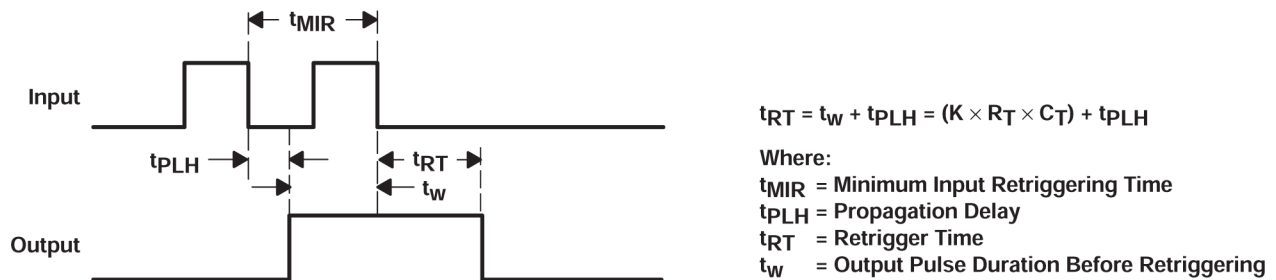
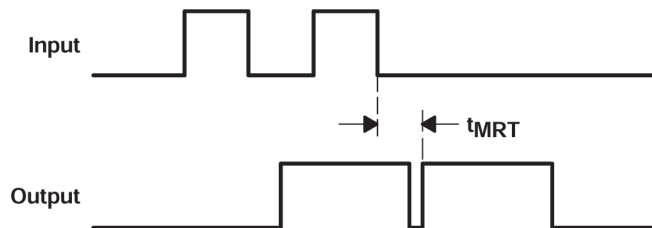


図 7-2. 再トリガパルス持続時間

再トリガされた出力を確保するためには、入力パルスの終わりから再トリガされた出力の開始までの最小値は約 15ns である必要があります (図 7-3 を参照)。



t_{MRT} = Minimum Time Between the End of the Second Input Pulse and the Beginning of the Retriggered Output
 $t_{MRT} = 15 ns$

図 7-3. 入力/出力要件

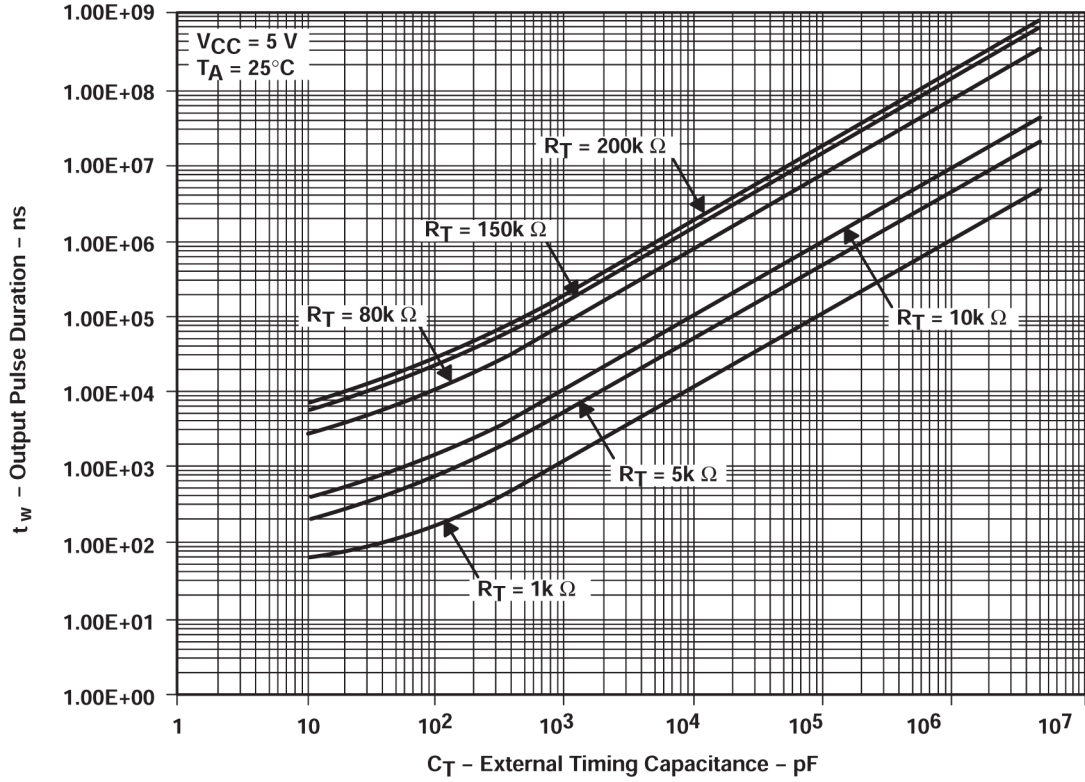


図 7-4. 出力パルス持続時間と外部タイミング容量との関係

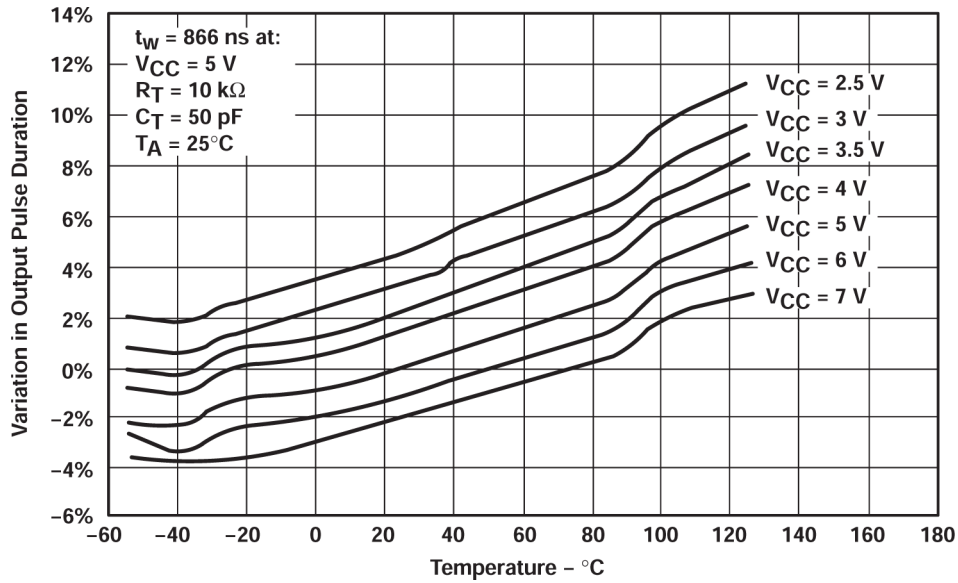


図 7-5. 出力パルス持続時間の変動幅と温度との関係

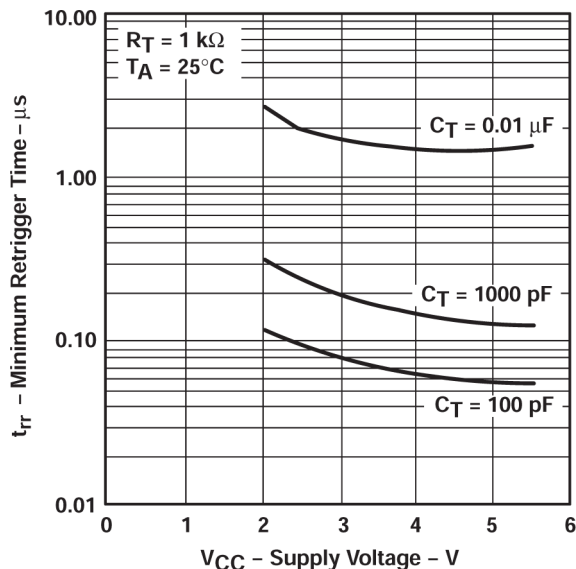


図 7-6. 最小トリガ時間と V_{CC} 特性との関係

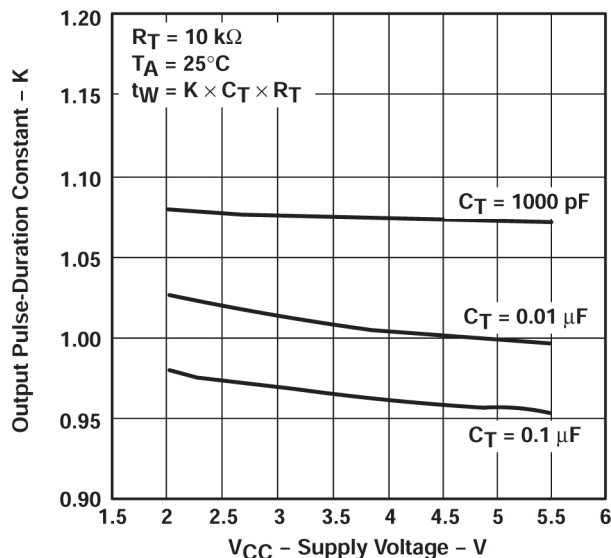


図 7-7. 出力パルス持続時間定数と電源電圧との関係

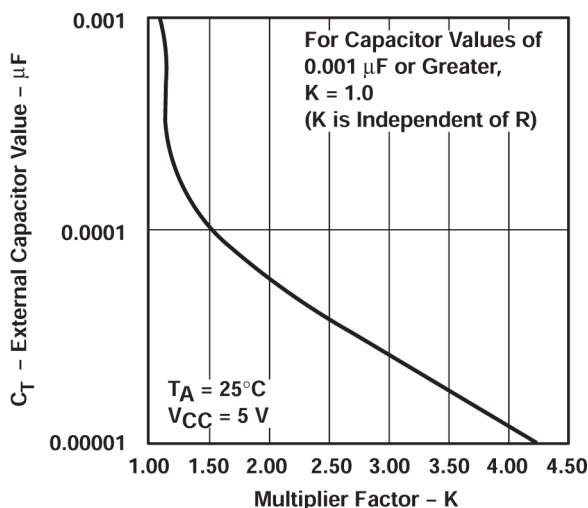


図 7-8. 外部静電容量と乗数との関係

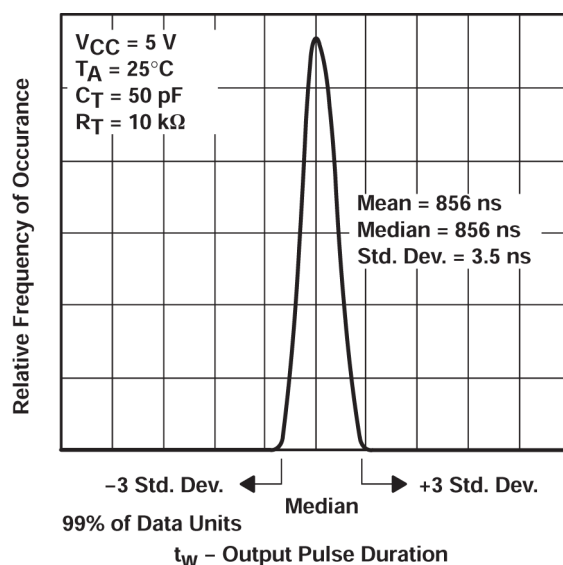


図 7-9. 単位数の分布と出力パルス持続時間との関係

7.2 電源に関する推奨事項

電源には、「推奨動作条件」に記載された電源電圧定格の最小値と最大値の間の任意の電圧を使用できます。電源の外乱を防止するため、各 V_{CC} 端子に適切なバイパスコンデンサを配置する必要があります。このデバイスには $0.1\mu\text{F}$ のコンデンサを推奨します。複数のバイパスコンデンサを並列に配置して、異なる周波数のノイズを除去することが許容されます。一般的に、 $0.1\mu\text{F}$ と $1\mu\text{F}$ のコンデンサは並列に使用されます。バイパスコンデンサを電源端子のできるだけ近くに配置すると最適な結果が得られます。

7.3 レイアウト

7.3.1 レイアウトのガイドライン

- バイパスコンデンサの配置
 - デバイスの正電源端子の近くに配置

- 電氣的に短いグランド帰還パスを提供
- インピーダンスを最小化するため、広いパターンを使用
- 可能な場合はいつでも、ボードの同じ側にデバイス、コンデンサ、パターンを配置
- 信号トレースの形状
 - 8mil~12mil のトレース幅
 - 伝送ラインの影響を最小化する 12cm 未満の長さ
 - 信号トレースの 90° のコーナーは避ける
 - 信号トレースの下に、途切れのないグランド プレーンを使用
 - 信号トレース周辺の領域をグランドでフラッド フィル
 - 12cm を超えるパターン用
 - インピーダンス制御トレースを使用
 - 出力の近くに直列ダンピング抵抗を使用して、ソース終端
 - 分岐を回避。個別に分岐が必要なバッファ信号

7.3.2 レイアウト例

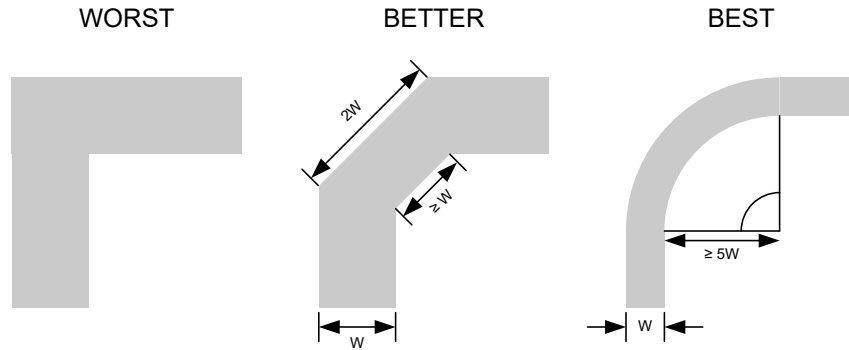


図 7-10. シグナル インテグリティ向上のためのサンプル パターンのコーナー

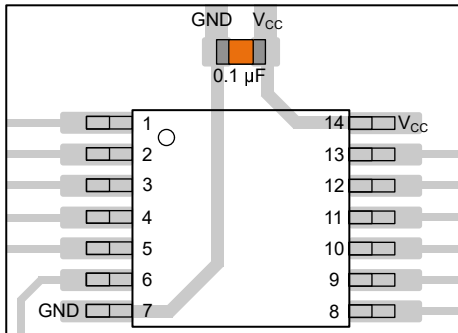


図 7-11. TSSOP や類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

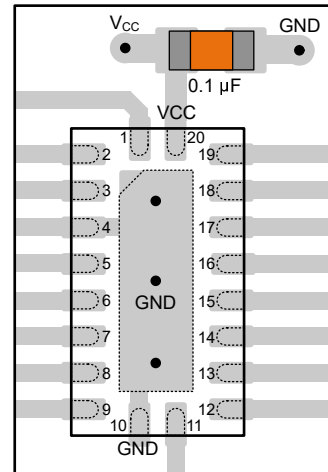


図 7-12. WQFN や類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

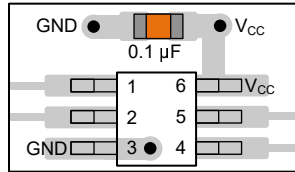


図 7-13. SOT、SC70、および類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

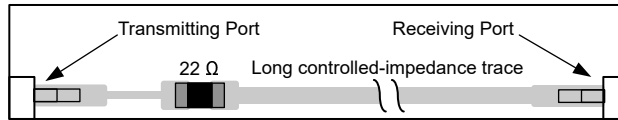


図 7-14. シグナル インテグリティ向上のためのダンピング抵抗の配置例

8 デバイスおよびドキュメントのサポート

テキサス・インスツルメンツは、幅広い開発ツールを提供しています。デバイスの性能の評価、コードの生成、ソリューションの開発を行うためのツールとソフトウェアを以下で紹介します。

8.1 ドキュメントのサポート

8.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インスツルメンツ、『**CMOS の消費電力と C_{pd} の計算**』アプリケーション・レポート
- テキサス・インスツルメンツ、『**ロジックを使用した設計**』アプリケーション・レポート
- テキサス・インスツルメンツ、『**標準リニアおよびロジック (SLL) パッケージおよびデバイスの熱特性**』アプリケーション・レポート

8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

8.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ **E2E™ サポート・フォーラム** は、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの [使用条件](#) を参照してください。

8.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

8.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

8.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

9 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision H (October 2005) to Revision I (January 2025)

Page

- | | |
|---|---|
| • 「製品情報」表、「ピンの機能」表、「ESD 定格」表、「熱に関する情報」表、「デバイスの機能モード」、「アプリケーションと実装」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、および「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加..... | 1 |
| • データシート全体にわたってマシン モデルへの参照を削除..... | 4 |

10 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
5962-9860801Q2A	ACTIVE	LCCC	FK	20	55	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	5962-9860801Q2A SNJ54AHC 123AFK	Samples
5962-9860801QEA	ACTIVE	CDIP	J	16	25	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	5962-9860801QE A SNJ54AHC123AJ	Samples
5962-9860801QFA	ACTIVE	CFP	W	16	25	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	5962-9860801QF A SNJ54AHC123AW	Samples
SN74AHC123AD	OBSOLETE	SOIC	D	16		TBD	Call TI	Call TI	-40 to 85	AHC123A	
SN74AHC123ADBR	ACTIVE	SSOP	DB	16	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	HA123A	Samples
SN74AHC123ADGVR	ACTIVE	TVSOP	DGV	16	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	HA123A	Samples
SN74AHC123ADGVRE4	ACTIVE	TVSOP	DGV	16	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	HA123A	Samples
SN74AHC123ADR	ACTIVE	SOIC	D	16	2500	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	AHC123A	Samples
SN74AHC123AN	ACTIVE	PDIP	N	16	25	RoHS & Green	NIPDAU	N / A for Pkg Type	-40 to 85	SN74AHC123AN	Samples
SN74AHC123APWR	ACTIVE	TSSOP	PW	16	2000	RoHS & Green	NIPDAU SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	HA123A	Samples
SN74AHC123APWRG4	ACTIVE	TSSOP	PW	16	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	HA123A	Samples
SNJ54AHC123AFK	ACTIVE	LCCC	FK	20	55	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	5962-9860801Q2A SNJ54AHC 123AFK	Samples
SNJ54AHC123AJ	ACTIVE	CDIP	J	16	25	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	5962-9860801QE A SNJ54AHC123AJ	Samples
SNJ54AHC123AW	ACTIVE	CFP	W	16	25	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	5962-9860801QF A SNJ54AHC123AW	Samples

⁽¹⁾ The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.

⁽²⁾ **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

⁽³⁾ MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

⁽⁴⁾ There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

⁽⁵⁾ Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

⁽⁶⁾ Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN54AHC123A, SN74AHC123A :

● Catalog : [SN74AHC123A](#)

● Enhanced Product : [SN74AHC123A-EP](#), [SN74AHC123A-EP](#)

● Military : [SN54AHC123A](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product
- Enhanced Product - Supports Defense, Aerospace and Medical Applications
- Military - QML certified for Military and Defense Applications

TAPE AND REEL INFORMATION

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SN74AHC123ADBR	SSOP	DB	16	2000	330.0	16.4	8.35	6.6	2.4	12.0	16.0	Q1
SN74AHC123ADGVR	TVSOP	DGV	16	2000	330.0	12.4	6.8	4.0	1.6	8.0	12.0	Q1
SN74AHC123ADR	SOIC	D	16	2500	330.0	16.4	6.5	10.3	2.1	8.0	16.0	Q1
SN74AHC123APWR	TSSOP	PW	16	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
SN74AHC123APWRG4	TSSOP	PW	16	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
SN74AHC123ADBR	SSOP	DB	16	2000	356.0	356.0	35.0
SN74AHC123ADGVR	TVSOP	DGV	16	2000	356.0	356.0	35.0
SN74AHC123ADR	SOIC	D	16	2500	353.0	353.0	32.0
SN74AHC123APWR	TSSOP	PW	16	2000	356.0	356.0	35.0
SN74AHC123APWRG4	TSSOP	PW	16	2000	367.0	367.0	35.0

TUBE


*All dimensions are nominal

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	T (μm)	B (mm)
5962-9860801Q2A	FK	LCCC	20	55	506.98	12.06	2030	NA
5962-9860801QFA	W	CFP	16	25	506.98	26.16	6220	NA
SN74AHC123AN	N	PDIP	16	25	506	13.97	11230	4.32
SNJ54AHC123AFK	FK	LCCC	20	55	506.98	12.06	2030	NA
SNJ54AHC123AW	W	CFP	16	25	506.98	26.16	6220	NA

DGV (R-PDSO-G**)

PLASTIC SMALL-OUTLINE

24 PINS SHOWN



4073251/E 08/00

- NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
 B. This drawing is subject to change without notice.
 C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion, not to exceed 0,15 per side.
 D. Falls within JEDEC: 24/48 Pins – MO-153
 14/16/20/56 Pins – MO-194

W (R-GDFP-F16)

CERAMIC DUAL FLATPACK



- NOTES:
- A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - C. This package can be hermetically sealed with a ceramic lid using glass frit.
 - D. Index point is provided on cap for terminal identification only.
 - E. Falls within MIL STD 1835 GDFP2-F16

GENERIC PACKAGE VIEW

FK 20

LCCC - 2.03 mm max height

8.89 x 8.89, 1.27 mm pitch

LEADLESS CERAMIC CHIP CARRIER

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.



4229370VA\

J (R-GDIP-T**)

14 LEADS SHOWN

CERAMIC DUAL IN-LINE PACKAGE



DIM \ PINS **	14	16	18	20
A	0.300 (7,62) BSC	0.300 (7,62) BSC	0.300 (7,62) BSC	0.300 (7,62) BSC
B MAX	0.785 (19,94)	.840 (21,34)	0.960 (24,38)	1.060 (26,92)
B MIN	—	—	—	—
C MAX	0.300 (7,62)	0.300 (7,62)	0.310 (7,87)	0.300 (7,62)
C MIN	0.245 (6,22)	0.245 (6,22)	0.220 (5,59)	0.245 (6,22)



4040083/F 03/03

- NOTES:
- All linear dimensions are in inches (millimeters).
 - This drawing is subject to change without notice.
 - This package is hermetically sealed with a ceramic lid using glass frit.
 - Index point is provided on cap for terminal identification only on press ceramic glass frit seal only.
 - Falls within MIL STD 1835 GDIP1-T14, GDIP1-T16, GDIP1-T18 and GDIP1-T20.

N (R-PDIP-T**)

PLASTIC DUAL-IN-LINE PACKAGE

16 PINS SHOWN





- NOTES:
- A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - Falls within JEDEC MS-001, except 18 and 20 pin minimum body length (Dim A).
 - The 20 pin end lead shoulder width is a vendor option, either half or full width.

D (R-PDSO-G16)

PLASTIC SMALL OUTLINE



- NOTES:
- A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 -  C. Body length does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.006 (0,15) each side.
 -  D. Body width does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.017 (0,43) each side.
 - E. Reference JEDEC MS-012 variation AC.



4220204/A 02/2017

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

PW0016A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X



SOLDER MASK DETAILS

4220204/A 02/2017

NOTES: (continued)

- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0016A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220204/A 02/2017

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

DB0016A



PACKAGE OUTLINE

SSOP - 2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



4220763/A 05/2022

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. Reference JEDEC registration MO-150.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

DB0016A

SSOP - 2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X



4220763/A 05/2022

NOTES: (continued)

- 5. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 6. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DB0016A

SSOP - 2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220763/A 05/2022

NOTES: (continued)

7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適したテキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、ます。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されているテキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかるテキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated